

フレキシブルプリント配線板用銅張積層板 Material for Flexible Printed Wiring Boards

フレキシブルプリント配線用副資材 Material for Flexible Printed Wiring Boards

ニカフレックス® NIKAFLEX®

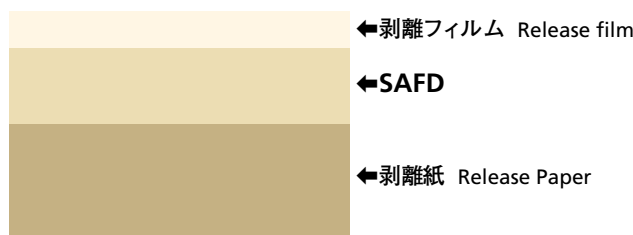
接着剤 (半硬化) シート
(Semicured) Adhesive Sheet

SAFD

特長 Features

- 1 耐熱性に優れる。Tg70°C (TMA法)
Excellent in heat resistance. Tg70°C (TMA)
- 2 ドリル加工性に優れ多層用材料に適する。
Excellent in drilling properties and suitable for multilayer.
- 3 電気特性に優れる。
Excellent in insulation resistance.
- 4 リジッドフレックス及びフレキ多層に最適。
It is optimized by Rigid-Flex and flexible multilayer.

構成 Composition



標準製品仕様 Specifications of standard Products

接着剤 Adhesive	種類 Classification	熱硬化性樹脂 Thermosetting Resin
	厚さ (μm) Thickness	25, 40
接着剤面の保護材 Releasing Material on Adhesive Surface		剥離フィルム Release Film
		剥離紙 Release Paper
標準サイズ (mm) Standard size		500×Roll (100m)

使用上の注意点 Caution

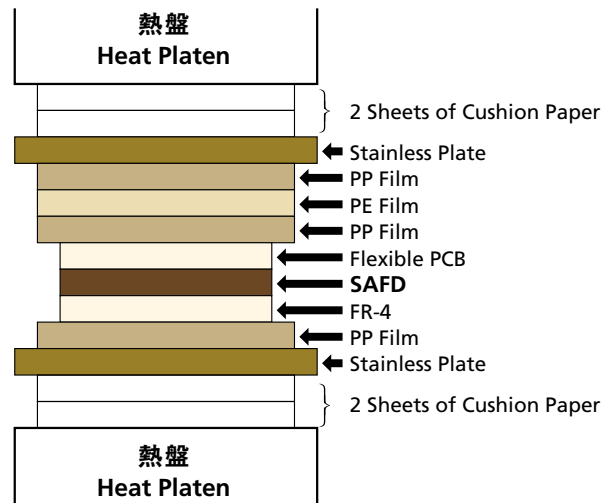
- 1 接着剤は半硬化となっておりますので、常温で放置しておきますと接着剤の硬化が急速に進行致しますので、保管は低温 (5°C以下)、湿度80%以下で管理して下さい。
Time and temperature rapidly promote a change from the semicured to the fully cure adhesive state, so keep SAFD at 5°C or below and at 80%RH or below.
- 2 保証期間は未開封の状態では製造後4ヵ月です。
Guaranteed period for SAFD before unpacked is 4 months after manufacture.
- 3 プレスパッドとして紙を使用する場合、紙中水分により接着剤が劣化し、接着剤とフィルムが剥離する場合がありますので使用前にご確認ください。
Moisture in press pads mode of paper might make adhesiveness weaker and cause delamination of adhesive and polyimide film. If paper is used as press pads, be sure to check condition of press pads paper before using that.

加工方法例 An Example of Processing Method

プレス手順 Procedures (Press-Bonding)

- 1** 常温セット
Setting at room temp.
- 2** エアー抜き 5回程度
Removing Air (about 5 times)
- 3** 圧力セット (2~4MPa)
Apply pressure (2 to 4 MPa)
- 4** 温度上昇
Temp. Elevation
- 5** 100℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 100℃
- 6** 圧力セット (2~4MPa)
Apply pressure (2 to 4 MPa)
- 7** 140~160℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 140~160℃
- 8** 160℃、2~4MPa、40~90分セット
Press-bonding at 160℃ under pressure of 2~4MPa for 40 to 90 min.
- 9** 冷却
Cooling
- 10** 取出し
Taking out

プレスセット例 Materials assembly for Press-bonding



SAFDの性能例 Characteristic of SAFW

試験項目 Test item	単位 Unit	処理条件 Treatment conditions	標準値 (平均) Our Standard Value (Average)	保証値 (平均) Guaranteed Value (Average)	試験方法 Test Method
接着剤フロー Resin Flow	mm	A	0.6 (製造時) (at the point of manufacturing)	1.5以下 (Max.)	弊社方式 Our Standard
引きはがし強さ Peel Strength	N/mm	A	1.5	1.0以上 (Min.)	JPCA-BM-02B法
		薬品浸漬処理後 After immersion in chemical	1.2	0.6以上 (Min.)	弊社方式 Our Standard
はんだ耐熱性 Solder Heat Resistance	—	260℃/20sec.	合格 Pass	合格 Pass	IPC-FC-232B

- Note** (1) 接着剤フロー、引きはがし強さ、はんだ耐熱性については35 μm電解銅箔光沢面と、FR-4 (銅なし板) をSAFD25で接着した時の値です。
Value of resin flow, peel strength, solder resistance are those of laminate using SAFD25 as adhesive in press-bonding the shiny side of electrolytic copper foil (35μm, 1 once) with unclad FR-4.
- (2) プレス条件/温度:160℃、時間:90分、成形圧力:4MPa
Press conditions: 16℃/90min./molding pressure 4MPa